

峰昭科技（深圳）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 峰昭科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司（含孙公司）拟向银行申请总额不超过人民币1.8亿元（含本数）的综合授信额度。

峰昭科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日分别召开了公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（含孙公司）向银行申请总额不超过人民币1.8亿元（含本数）的综合授信额度。公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

为满足公司经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（含孙公司）拟向银行申请总额不超过人民币1.8亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证等，具体授信业务品种、额度和期限以金融机构最终审批为准。该综合授信事项有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发

展的实际需求来合理确定。

为提高效率，公司董事会授权董事长或董事长授权代表在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。

特此公告。

峰昭科技（深圳）股份有限公司董事会

2023年4月26日